

附件 3

享受税收优惠政策的集成电路企业、项目和软件企业提交材料明细表

企业或项目类型	材料清单（复印件须加盖企业公章）
享受《若干政策》第（一）条的集成电路生产企业或项目	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址） 2.项目备案文件（备案表）；（可提供相应查询网址） 3.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料； 4.企业主要工艺、产品列表（名称/规格）； 5.企业拥有与主营产品相关的发明专利等证明材料； 6.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路制造销售（营业）收入、自有集成电路产品制造销售（营业）收入、研究开发费用等情况表； 7.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件； 8.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等）； 9.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。
享受《若干政策》第（三）、（七）条的重点集成电路设计企业	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址） 2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料； 3.企业开发销售的主要产品和服务列表（名称/重点领域/对应销售（营业）收入规模）； 4.企业拥有与主营产品相关的不少于 8 项的已授权发明专利、布图设计登记、计算机软件著作权登记证书的证明材料； 5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路设计销售（营业）收入、集成电路自主设计销售（营业）收入、研究开发费用等情况表； 6.第三方检测机构提供的集成电路产品测试报告或用户报告，以及与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件； 7.企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境的证明材料； 8.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。

企业或项目类型	材料清单（复印件须加盖企业公章）
享受《若干政策》第（三）、（七）的重点软件企业	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址） 2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料； 3.企业开发销售的主要软件产品列表（名称/重点领域/对应销售（营业）收入规模）； 4.企业具有所申报领域相应的已授权发明专利不少于2项，相应领域计算机软件著作权登记证书不少于2项（均应具备对应的测试报告）的证明材料； 5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及软件产品开发销售及相关信息技术服务（营业）收入、软件产品自主开发销售（营业）收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况表。 6.汇算清缴年度与申报领域相关的合同列表及销售凭证； 7.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件； 8.企业具有与软件开发相适应软硬件设施等开发环境（如合法的开发工具等）的证明材料； 9.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。
享受《若干政策》第（六）条的集成电路生产企业和财关税〔2021〕4号文提及的关键原材料、零配件生产企业	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址） 2.项目备案文件（备案表）（可提供相应查询网址）； 3.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等），先进封装、测试企业需提供按封装产品颗粒数或晶圆数（折合8英寸）计算，先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、2.5维和3维封装）规划产能占总规划产能比例不低于40%的证明材料； 4.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。
享受《若干政策》第（八）条的集成电路重大项目	1.项目企业对应类别集成电路企业条件材料清单； 2.固定资产投资额相关证明材料； 3.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。

注：上述企业类型、材料清单依据国发〔2020〕8号文制定，材料模板请咨询省级发展改革委（工业和信息化主管部门），填报说明见信息填报系统。